

【会員限定】2024年度第1回 先端半導体パッケージWG研究会

【会場】大阪大学産業科学研究所
インキュベーション棟1階 講義室(I-117)

2024年

受付13:00～

6/5

水

13:30～19:00

13:30-13:35 開会挨拶 菅沼克昭 所長・特任教授 大阪大学産業科学研究所F3D実装協働研究所

13:35-14:50 多様化するチップレットパッケージングの最新動向



講師：西尾 俊彦氏

株式会社SBRテクノロジー
代表取締役

生成AIの学習モデルのパラメータ数の拡大は2年で100倍以上に増大し、同じトレーニング時間を達成するためには250倍以上のFLOPSの進化求められる。そのような背景からチップレットパッケージに搭載するコア数、メモリー容量、チップレット間のバンド幅の最大化実現が求められる。そのためにスケーラブルなチップレットが求められ、巨大なインターポーザー部分を支えるガラスコアサブストレートも登場する。3D Hybrid Bondingの導入は性能面からは必然でも発熱密度はさらに上がり、熱変形についてもより配慮が必要となる。CPO(Co-Packaged Optics)によるパッケージ間光接続はスケーラビリティ要求から導入されるが光電変換の課題は多い。さらにビヨンド2nにおいてはBSPDN(Back Side Power Delivery Network)が必要なほど電源性能が重要となる。本発表では、このトレンドに対して開発中の様々なチップレットの実装オプションに対して、スケーラビリティ、性能、信頼性、デザイン性、コストの視点から最新のチップレットをベンチマークする事で、さらなる挑戦課題を浮彫にする事を目的とする。

14:50-15:10 休憩・講師との名刺交換会

15:10-16:25 サプライチェーンから見た先端パッケージ動向 日本の強みと弱点



講師：亀和田 忠司氏

AZ Supply Chain Solutions
オーナー

半導体技術は、従来の前工程技術を中心としたチップの微細化に加えて、パッケージレベルでの高集積化が加速されている。パッケージ技術の動向と、地政学的リスクも含めたサプライチェーンに与える影響、その変化の中での日本のポジションを検証し、今後の課題について考察する。

16:25-16:45 新規会員企業の自社紹介
①RIMTEC(株) ②エスタカヤ(株)

17:00-19:00 講演者を交えた意見交換会(別会場)